

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-306533
(P2000-306533A)

(43) 公開日 平成12年11月2日 (2000. 11. 2)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
H 0 1 J 35/08		H 0 1 J 35/08	F
	9/14	9/14	E
	35/18	35/18	M

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 6 頁)

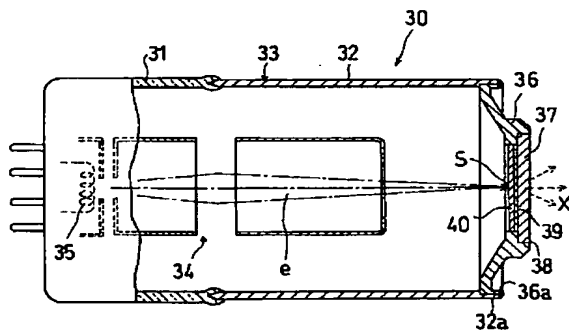
(21) 出願番号	特願平11-371002	(71) 出願人	000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(22) 出願日	平成11年12月27日 (1999. 12. 27)	(71) 出願人	000221339 東芝電子エンジニアリング株式会社 神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1
(31) 優先権主張番号	特願平11-41392	(72) 発明者	香澤 宏樹 神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1 東芝電子エンジニアリング株式会社内
(32) 優先日	平成11年2月19日 (1999. 2. 19)	(74) 代理人	100081732 弁理士 大胡 典夫 (外1名)
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

(54) 【発明の名称】 透過放射型X線管およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 この発明は、X線透過窓板とターゲット薄膜との間の界面剥離を未然に防止し、信頼性の高い透過放射型X線管およびその製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 この発明は、真空容器33の一部に気密接合されたベリリウム製のX線透過窓板37と、このX線透過窓板の真空側の面に付着されX線を発生するタングステン製のターゲット薄膜40との間に、銅、クロム、鉄、或いはニッケル等から選択された少なくとも1つの金属元素またはそれを主体とする材料からなる少なくとも1層の中間薄膜39をスパッタリング等の物理的蒸着法で成膜したことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 真空容器の一部に気密接合されたベリリウム製の X 線透過窓板と、この X 線透過窓板の真空側に設けられ X 線を発生するタングステンまたはタングステンを主体とする合金からなるターゲット薄膜と、前記 X 線発生用ターゲット薄膜に照射する電子ビームを発生する陰極構体とを具備し、上記 X 線発生用ターゲット薄膜から発生する X 線を上記 X 線透過窓板を通して外部に放射させる構造の透過放射型 X 線管において、前記 X 線透過窓板と前記 X 線発生用ターゲット薄膜との間に、少なくとも 1 つの金属元素または該金属元素を主体とする材料からなる少なくとも 1 層の中間薄膜が前記 X 線透過窓板および X 線発生用ターゲット薄膜にそれぞれ密着して設けられていることを特徴とする透過放射型 X 線管。

【請求項 2】 上記中間薄膜は、銅、クロム、鉄、ニッケル、シリコン、チタン、ジルコニウム、ニオブ、ロジウム、金、銀、或いはそれらを主体とする合金または化合物から選択された材質である請求項 1 記載の透過放射型 X 線管。

【請求項 3】 上記中間薄膜は、上記ターゲット薄膜を構成している主体であるタングステンよりも原子番号が小さい金属元素または該金属元素を主体とする材料である請求項 1 記載の透過放射型 X 線管。

【請求項 4】 上記中間薄膜は、その厚さが上記ターゲット薄膜の厚さの 1/50、乃至、1/2 の範囲である請求項 1 記載の透過放射型 X 線管。

【請求項 5】 真空容器の一部に気密接合されたベリリウム製の X 線透過窓板と、この X 線透過窓板の真空側に設けられ X 線を発生するタングステンまたはタングステンを主体とする合金からなるターゲット薄膜と、前記 X 線発生用ターゲット薄膜に照射する電子ビームを発生する陰極構体とを具備し、上記 X 線発生用ターゲット薄膜から発生する X 線を上記 X 線透過窓板を通して外部に放射させる構造の透過放射型 X 線管の製造方法において、前記 X 線透過窓板の前記 X 線発生用ターゲット薄膜が設けられ側の面上に、少なくとも 1 つの金属元素または該金属元素を主体とする材料からなる少なくとも 1 層の中間薄膜を成膜し、さらにこの中間薄膜上に上記 X 線発生用ターゲット薄膜を成膜することを特徴とする透過放射型 X 線管の製造方法。

【請求項 6】 上記中間薄膜または X 線発生用ターゲット薄膜は、スパッタリング法、イオンプレーティング法、または真空蒸着法等の物理的蒸着法で成膜する請求項 5 記載の透過放射型 X 線管の製造方法。

【請求項 7】 上記真空容器の一部を構成する X 線透過窓保持用リングを予め用意し、この X 線透過窓保持用リングに上記 X 線透過窓板を気密接合し、その後前記 X 線透過窓板の内面側に中間薄膜および X 線発生用ターゲット薄膜を順次成膜し、その後上記 X 線透過窓保持用リ

ングを真空容器の残りの部分に気密接合する請求項 5 記載の透過放射型 X 線管の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、透過放射型 X 線管およびその製造方法に係わり、とくにその真空容器の一部を兼ねる X 線放射窓板の内面に形成した X 線発生用ターゲット薄膜の界面剥離を未然に防止するようにしたこの種 X 線管およびその製造方法に関する

【0002】

【従来の技術】X 線管は、陽極ターゲットに電子ビームを衝突させて X 線を発生する構成になっている。この X 線管は、医療診断装置、非破壊検査や材料分析等の工業用など、多くの用途に利用されている。そして、用途に応じていろいろな種類の X 線管が実用化されている。その 1 つに、微小焦点すなわちマイクロフォーカス X 線管を生源を得る透過放射型 X 線管がある。

【0003】このマイクロフォーカス透過放射型 X 線管の用途の一つは、半導体集積回路基板やその他の物体の X 線透視拡大撮影装置である。その概略構成は、図 7 に示すように、X 線遮蔽された装置ケース 11 の内部に X 線管 12 が配置されている。そして、この X 線管 12 の X 線発生焦点位置 S から距離 La だけ離れた位置に半導体集積回路基板のような被撮影物体 13 が置かれる。また、この被撮影物体 13 の位置からさらに距離 Lb だけ離れた位置に、X 線イメージ管または固体 X 線センサのような X 線エリアセンサ 14 のセンサ面が位置するように配置されている。

【0004】X 線管 12 には、ケース 11 に内蔵された電源 15 から動作電圧が供給されるようになっており、これは外部から制御される。また、X 線エリアセンサ 14 の X 線画像信号出力部 16 から出力される X 線画像信号は、画像処理装置を内蔵するモニタ 17 に送られ、画像表示部 18 に被撮影物体 13 の X 線透視拡大撮影映像が表示されるように構成されている。

【0005】被撮影物体の X 線撮影の拡大率 M は、概ね、 $M = (La + Lb) / La$ であらわされる。ただし、 $(La \ll Lb)$ となるように設定するため、距離 La を小さくするほど拡大率 M は大きくなる。また、X 線管の X 線生源である焦点 S のサイズが小さければ小さいほど、解像度の高い鮮明な X 線透視拡大撮影画像が得られることも自明である。

【0006】そのため、X 線管の焦点 S、すなわち X 線発生ターゲット部分をできるだけ被撮影物体 13 の近くに配置して、距離 La を可能な限り小さくできる構成が望ましい。この目的には、X 線発生ターゲット部が X 線管の最先端に存在するマイクロフォーカス透過放射型 X 線管の使用が適する。

【0007】この型の X 線管 12 は、図 8 に示すように、真空容器 21 の一方の側の金属円筒部の先端部に、

10

20

30

40

50

X線を透過するX線透過窓板22が真真空気密に設けられている。この透過窓板22は、通常、ベリリウム(Be)などX線に対する透過率の高い材料で構成されている。また、このX線透過窓板22の真空側の面には、要部を拡大して示すように、タングステン(W)などからなる陽極ターゲット薄膜23が直接付着されている。そして、真空容器内の他方側のガラス部分内に電子ビームを発生する陰極24が配置され、それと電子レンズ用の複数個のグリッド電極からなる電子銃25が配置されている。

【0008】上記した構成において、陰極から発生されて電子銃25を経た電子ビームeは、陽極ターゲット薄膜23の位置で焦点Sを結ぶようになっている。そして、この陽極ターゲット薄膜で発生したX線がそのまま透過窓板22を通して外部に放射される。この放射X線を符号Xであらわしており、X線撮影に利用される。

【0009】このような装置或いはX線管は、例えば米国特許第5077771号明細書、日本特許第2713860号、同特許第2634369号、特公平7-50594号、特開平9-171788号、実公昭52-56778号、或いは実開昭54-163885号の各公報等に開示されている。

【0010】なお、透過放射型X線管の陽極ターゲットを構成するタングステン薄膜の膜厚は、X線管に印加する電圧によって最適な膜厚が相違している。たとえば、工業用に使用されるX線管の場合、X線管に印加される電圧は数十kV～百数十kVの範囲が一般的になっている。このような場合、陽極ターゲットを構成するタングステン薄膜の最適な膜厚は、数 μm ～10数 μm の範囲となる。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】ところで、陽極ターゲットを構成するタングステン薄膜をベリリウム製X線透過窓板の内面に直接付着させた構造は、タングステン薄膜を形成する際に発生する薄膜中の残留応力、あるいは、透過窓板を構成するベリリウムとの熱膨張差などが影響して、ベリリウムとの間で界面剥離が起きやすく、不安定なものになりやすい。

【0012】とくに、マイクロフォーカス透過放射型X線管においては、タングステン薄膜に例えば直径が数十 μm またはそれ以下の略円形の焦点サイズとなる電子ビームを衝突させるため、この微小焦点部分で界面剥離が起こりやすい。この界面剥離が起こった場合には、電子ビームの局部照射によるタングステン薄膜の溶融や剥離物の飛散などにより、X線管の致命的な損傷に至る場合も考えられる。

【0013】この発明は、上記した欠点を解決するもので、X線透過窓板とターゲット薄膜との間の界面剥離を未然に防止し、信頼性の高い透過放射型X線管およびその製造方法を提供することを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】この発明は、真空容器の一部に気密接合されたベリリウム製のX線透過窓板と、このX線透過窓板の真空側に設けられX線を発生するタングステンまたはタングステンを主体とする合金からなるターゲット薄膜との間に、例えば銅のような少なくとも1つの金属元素またはこの金属元素を主体とする材料からなる少なくとも1層の中間薄膜がこれらX線透過窓板およびX線発生用ターゲット薄膜にそれぞれ密着して設けられている透過放射型X線管である。

【0015】また、この発明の製造方法は、ベリリウム製X線透過窓板の内面上に、少なくとも1つの金属元素、例えば銅やクロム、鉄、或いはニッケル等から選択された金属元素またはこの金属元素を主体とする材料からなる少なくとも1層の中間薄膜、さらにこの中間薄膜上にX線発生用ターゲット薄膜を例えばスパッタリング等の物理的蒸着法で成膜することを特徴とする。

【0016】

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について図1乃至図4を参照して説明する。同図に示すマイクロフォーカス透過放射型X線管30は、ガラス容器部分31および先端が閉じられた金属円筒容器部分32が真真空気密に接合された真空容器33を備えている。この真空容器33の内部には、電子銃34が配置されている。この電子銃34は、電子ビームを発生する陰極35、および電子レンズ用の複数個のグリッド電極を備えている。なお、ここで説明するX線管の例は、電子ビーム加速電圧すなわち陰極と陽極ターゲット薄膜との間に印加される動作電圧が、50～70kVの範囲のものである。

【0017】さて、真空容器の金属円筒容器部分32の先端部は、X線放射窓保持用リング36に、X線透過率の高い材料であるベリリウム(Be)またはベリリウムを主体とする合金からなるX線透過窓37が、ろう材層38により真真空気密にろう接されている。X線放射窓保持用リング36は、厚肉の鉄(Fe)、またはコパール(商品名)やステンレス鋼のような鉄合金、或いは銅(Cu)または銅合金のような機械的に高強度の材料で形成されている。そして、そのテーパ状に外方に延長された外周薄肉部36aが、金属円筒容器部分の先端開口部32aにヘリアーク溶接により真真空気密接合されている。

【0018】ベリリウム製のX線透過窓板37の内面すなわち真空領域側の面には、純銅(Cu)からなる中間薄膜39、およびタングステン(W)からなる陽極ターゲット薄膜40が、この順に成膜され、積層して付着されている。なお、このX線管の動作に際しては、従来技術で述べたと同様に、陰極35から発生され電子銃34を経た電子ビームeは、陽極ターゲット薄膜40の位置で焦点Sを結ぶようになっている。そして、この焦点位置で発生したX線は、そのままX線透過窓37を通して

符号Xで示すように外部に放射され、X線撮影等に利用される。

【0019】次に、X線透過窓板37、中間薄膜39および陽極ターゲット薄膜40の好ましい組立て、或いは成膜プロセスを、図3および図4により説明する。まず、図3の(a)に示すように、予め所定形状に加工した窓保持用リング36の開口部の段差36bに、ろう材として例えば銀が50%と銅が50%の銀合金ろう材を配置し、さらに厚さが約1mmのベリリウム製円板からなるX線透過窓板37を配置し、非酸化性雰囲気中で加熱処理し、溶融ろう材38による気密ろう接を行なっ

た。

【0020】次に、これを図4に示すスパッタリング成膜装置50内に配置し、図3の(b)に示すように、窓保持用リング36に接合された状態のベリリウム製X線透過窓37の内面に、銅からなる中間薄膜39を、厚さがおよそ0.4μmとなるようにスパッタリング法により成膜し、直接付着させた。

【0021】次に、同じスパッタリング成膜装置内で、図3の(c)に示すように、銅からなる中間薄膜39の上に、タングステンの薄膜40を、厚さがおよそ4μmとなるようにスパッタリング法により成膜し、付着させた。その後、このように中間薄膜およびタングステン薄膜を成膜したX線透過窓板37を有する窓保持用リング36を、図1に示したように、金属円筒容器部分の先端開口部32aに嵌め、両者の合致した薄肉円筒端部をヘリアーク溶接により真空気密に接合して真空容器とし、この真空容器内に電子銃等を組み入れ、排気工程等を経てX線管を完成させた。

【0022】図4に示すスパッタリング成膜装置50は、普通に知られた直流(DC)二極スパッタリング装置である。同図の符号51は真空または減圧容器、52、53はスパッタリング用のターゲット材、54はこれらターゲット材を固定するターゲット固定台、55はシールド、56は絶縁体、57はターゲット材を冷却するためにターゲット固定台中に循環させる冷媒、58はシャッタ、59は被成膜基板を載置する基板載置台、60は排気ポンプ、61はアルゴンガスのような放電用ガスの導入を制御する制御弁、62は直流電源をそれぞれあらわしている。

【0023】そこで、図3の(a)に示したベリリウム製のX線透過窓板37をろう接した窓保持用リング36を基板載置台59の上に載せて、減圧容器51とともに接地電位とする。一方、ターゲット固定台54には、銅からなるターゲット材52、およびタングステンからなるターゲット材53を置き換え可能に固定する。このターゲット固定台54には、直流電源62のマイナス極を電氣的に接続してある。

【0024】そして、減圧容器51の内部を真空中に排気した後、矢印で示すように放電用ガス63を導入して例

えば10Pa程度の所定圧力に制御するとともに、直流電源62から例えば1kV程度の所定電圧を印加して減圧容器内に放電プラズマを発生させる。次に、シャッタ58を制御して、まず銅からなるターゲット材52からX線透過窓板37の面上に銅の中間薄膜を成膜する。

【0025】次に、タングステンからなるターゲット材53に置き換えて中間薄膜上にタングステンからなるターゲット薄膜を成膜する。こうして、図3の(c)に示したX線管の透過窓板37の内面に中間薄膜39およびターゲット薄膜40を連続的に積層して成膜する。

【0026】図5に示す実施例は、銅からなる中間薄膜39、およびタングステンからなるターゲット薄膜40を、ベリリウム製X線透過窓37の内面からさらに透過窓保持用リング36の内側テーパ面の途中まで延長してスパッタリング被覆したものである。これら中間薄膜およびターゲット薄膜の延長部分を、符号39a、40aでそれぞれあらわしている。

【0027】この実施例によれば、X線管の動作に何ら不都合がなく、むしろ中間薄膜39およびターゲット薄膜40の成膜に際して、マスキングを比較的ラフにしても差支えないという利点がある。

【0028】図6に示す実施例は、ベリリウム製X線透過窓板37の内面に2層39b、39cからなる中間薄膜39を積層して成膜し、その内面にターゲット薄膜40を成膜したものである。2層からなる中間薄膜39の材料は、例えばX線透過窓板側の中間薄膜39bを鉄(Fe)とし、ターゲット薄膜側の中間薄膜39cをチタン(Ti)としてもよい。それによって、熱膨張率が、X線透過窓板37であるベリリウムからターゲット薄膜40のタングステンに向かって大きい順に配列され、各層間の界面剥離が一層抑制される。

【0029】なお、中間薄膜39b、39cは、上記に限らず、例えば中間薄膜39bを金(Au)とし、中間薄膜39cをクロム(Cr)にすることもできる。或いはまた、中間薄膜39bを銅(Cu)とし、中間薄膜39cをタンタル(Ta)にすることもできる。その他、種々の組み合わせが可能である。また、2層に限らず、3層またはそれ以上に積層することも可能である。

【0030】このように製作したマイクロフォーカス透過放射型X線管は、微小焦点X線の放射を長時間継続しても、X線透過窓板から銅製中間薄膜およびタングステン製ターゲット薄膜の界面剥離が起らず、高い信頼性が得られた。その主な理由は、X線透過窓を構成するベリリウム板と銅からなる中間薄膜とが比較的合金化しやすいことと、スパッタリング成膜法により、高いエネルギーでベリリウム製窓材に中間薄膜が高付着力で付着され、さらに同様にこの中間薄膜にタングステン製ターゲット薄膜が高付着力で付着されるとともに、これら各界面部分で下地金属中へのイオン打込み現象が存在しているものと考えられる。こうして、各界面で良好な密着性

が得られ、界面剥離が生じ難くなっているものと考えられる。

【0031】ところで、金属中への電子の進入深さは、よく知られるように、同じ金属であれば電子の加速電圧の n 乗に比例する。ここで、 n は約1.7である。そこで、X線管の陽極ターゲットがタングステンである場合は、30 kVの加速電圧での電子の進入深さは約1 μ mであり、100 kVの加速電圧での電子の進入深さは約8 μ mである。

【0032】そのため、上記実施例のように、陽極ターゲットを構成しているタングステン薄膜の厚さを約4 μ mにした場合は、50 kVの加速電圧の動作での電子の進入深さはタングステン薄膜の表面から約2.5 μ mまで、70 kVの加速電圧の動作ではタングステン薄膜の表面から約4 μ mすなわちタングステン薄膜の厚さ概ね全体に進入し、X線を効率よく放射するとともに、銅の中間薄膜やベリリウム製X線透過窓板までは電子が到達せず、不都合を引き起こすことが未然に防止される。

【0033】なお、中間薄膜としては、陽極ターゲット薄膜の主体金属であるタングステンよりも原子番号が小さい金属元素またはそれを主体とする合金や化合物を使用することが、発生したX線を不所望に吸収しなのでとくに望ましい。しかし、中間薄膜として原子番号が比較的高い材料を使用しても、その厚さを薄く成膜すれば、この中間薄膜で吸収するX線量は無視できる程度に小さくすることが可能である。一方、中間薄膜の存在によって、若干ではあるが、ターゲット薄膜からの熱放散性も高められる。

【0034】このような理由に基づいて、この種X線管の用途、動作中の電子ビーム加速電圧の範囲を考慮して、陽極ターゲットを構成しているタングステン薄膜の厚さを最適な厚さに製作することができる。また、陽極ターゲット薄膜の素材は、純タングステンに限られず、例えばレニウム (Re) を微量含むレニウム・タングステン合金や、モリブデン (Mo) を微量含むモリブデン・タングステン合金、あるいはその他の元素を微量含むタングステン主体の合金を使用してもよい。

【0035】一方、中間薄膜39は、材料として上述のように純銅 (Cu) が好ましいが、それに限らず、他の元素を微量含んでもよく、あるいは次のような材料を使用できる。すなわち、例えばクロム (Cr)、鉄 (Fe)、ニッケル (Ni)、シリコン (Si)、チタン (Ti)、ジルコニウム (Zr)、ニオブ (Nb)、ロジウム (Rh)、金 (Au)、銀 (Ag)、或いはこれらの少なくとも1つの金属元素を主体とする合金または化合物から選択された材料であってもよい。或いはまた、これらから選択された材料の薄膜の1層であることに限らず、複数の薄膜の積層であってもよい。なお、前

述のように、陽極ターゲット薄膜の主体であるタングステンよりも原子番号やX線吸収率が小さく且つ融点が約950℃を超える金属材料の使用が、X線管の製造中または動作中の安定性のうえでとくに好ましい。

【0036】また、この中間薄膜39の厚さは、これとX線透過窓板37または陽極ターゲット薄膜との間の界面剥離を生じない範囲でできるだけ薄い方が望ましい。これを種々検討した結果、陽極ターゲット薄膜40の厚さの、1/50乃至1/2の範囲、より好ましくは、1/30乃至1/3の範囲にすることが望ましいことが確認できた。

【0037】なお、X線透過窓板37の厚さは、動作時も真空容器として安全且つ安定に機能する範囲で、可能な限り薄く構成することが望ましい。

【0038】中間薄膜、或いは陽極ターゲット薄膜の成膜方法は、上述のスバタリング法に限らず、イオンプレーティング法、或いは真空蒸着法などの、いわゆる物理的蒸着 (PVD) 法が適する。また、これらの方法の組合わせによって全体を成膜してもよい。

【0039】また、上記のX線という表現には、 γ 線など放射線を含むものとする。

【0040】

【発明の効果】この発明によれば、ベリリウム製X線放射窓板の内面に成膜したタングステン主体のターゲット薄膜の界面剥離を未然に防止でき、信頼性の高い透過放射型X線管およびその製造方法を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態を示すX線管の縦断面図である。

【図2】図1の要部を拡大して示す断面図である。

【図3】図1のX線放射窓板およびターゲット薄膜の組立および成膜プロセスを示す要部縦断面図である。

【図4】この発明の製造方法に適用するスバタリング装置を示す概略図である。

【図5】この発明の他の実施形態を示すX線管の要部縦断面図である。

【図6】この発明のさらに他の実施形態を示すX線管の要部縦断面図である。

【図7】X線拡大撮影装置を示す概略図である。

【図8】従来のX線管を示す縦断面図である。

【符号の説明】

33…真空容器

34…電子銃

36…X線透過窓保持用リング

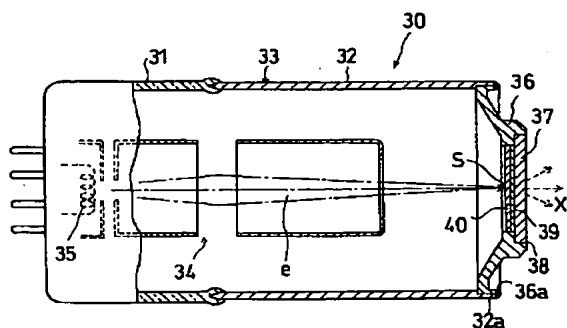
37…X線透過窓板

39…中間薄膜

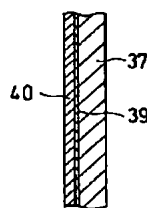
40…陽極ターゲット薄膜

50…スバタリング成膜装置

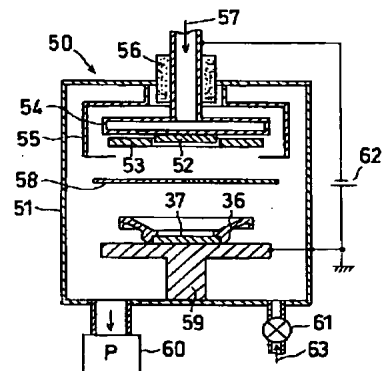
【図1】



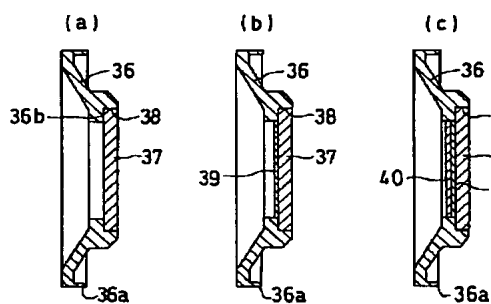
【図2】



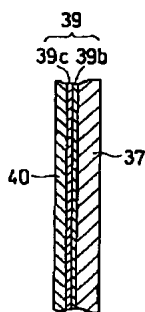
【図4】



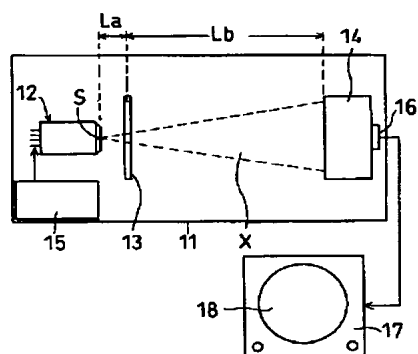
【図3】



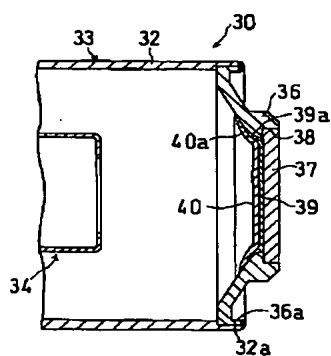
【図6】



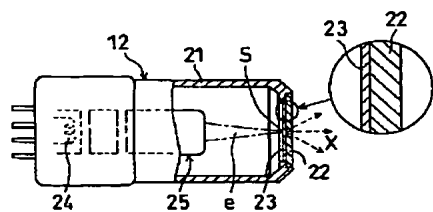
【図7】



【図5】



【図8】



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-306533

(43)Date of publication of application : 02.11.2000

(51)Int.Cl.

H01J 35/08

H01J 9/14

H01J 35/18

(21)Application number : 11-371002

(71)Applicant : TOSHIBA CORP
TOSHIBA ELECTRONIC
ENGINEERING CORP

(22)Date of filing : 27.12.1999

(72)Inventor : KUTSUZAWA HIROKI

(30)Priority

Priority number : 11041392

Priority date : 19.02.1999

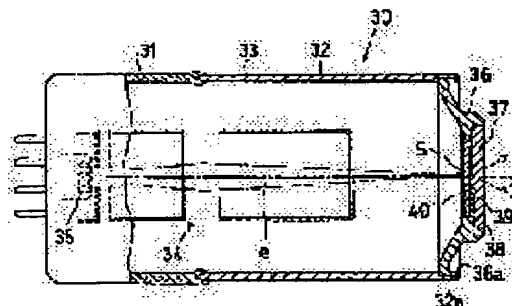
Priority country : JP

(54) TRANSMISSIVE RADIATION-TYPE X-RAY TUBE AND MANUFACTURE OF IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transmissive radiation-type X-ray tube having high reliability and a manufacturing method for it, by preventing an interfacial peeling between an X-ray transmission window plate and a target thin film.

SOLUTION: In a transmissive radiation-type X-ray tube 30, an intermediate thin film 39 of at least one layer made of at least one metallic element selected from copper, chromium, iron, nickel, or the like or a material taking these elements as a main component is formed between a beryllium-made X-ray transmission window plate 37 airtightly joined to a part of a vacuum container 33 and a tungsten-made target thin film 40 bonded to the surface on the vacuum side of the X-ray transmission window plate and for generating X rays by a physical vapor deposition method such as sputtering.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The target thin film which consists of an alloy which makes a subject the tungsten or tungsten which is prepared in a part of vacuum housing at the vacuum side of the radiopacity aperture plate made from beryllium by which airtight junction was carried out, and this radiopacity aperture plate, and generates an X-ray, In the transparency radiation mold X-ray tube of the structure of making the X-ray which possesses the cathode structure which generates the electron beam which irradiates said target thin film for X-ray generating, and is generated from the above-mentioned target thin film for X-ray generating emitting outside through the above-mentioned radiopacity aperture plate Between said radiopacity aperture plate and said target thin film for X-ray generating The transparency radiation mold X-ray tube characterized by for the middle thin film of at least one layer which consists of an ingredient which makes a subject at least one metallic element or this metallic element sticking to said radiopacity aperture plate and the target thin film for X-ray generating, respectively, and being prepared.

[Claim 2] The above-mentioned middle thin film is a transparency radiation mold X-ray tube according to claim 1 which is the quality of the material chosen from the alloy or compound which makes a subject copper, chromium, iron, nickel, silicon, titanium, a zirconium, niobium, a rhodium, gold, silver, or them.

[Claim 3] The above-mentioned middle thin film is a transparency radiation mold X-ray tube according to claim 1 which is the ingredient which makes a subject a metallic element with the atomic number smaller than the tungsten which is the subject who constitutes the above-mentioned target thin film, or this metallic element.

[Claim 4] The above-mentioned middle thin film is a transparency radiation mold X-ray tube according to claim 1 1/50 of the thickness of the above-mentioned target thin film thru/or the range of the thickness of whose are 1/2.

[Claim 5] The target thin film which consists of an alloy which makes a subject the tungsten or tungsten which is prepared in a part of vacuum housing at the vacuum side of the radiopacity aperture plate made from beryllium by which airtight junction was carried out, and this radiopacity aperture plate, and generates an X-ray, The cathode structure which generates the electron beam which irradiates said target thin film for X-ray generating is provided. In the manufacture approach of the transparency radiation mold X-ray tube of the structure of making the X-ray generated from the above-mentioned target thin film for X-ray generating emitting outside through the above-mentioned radiopacity aperture plate Said target thin film for X-ray generating of said radiopacity aperture plate is prepared. On a near field The manufacture approach of the transparency radiation mold X-ray tube characterized by forming the middle thin film of at least one layer which consists of an ingredient which makes a subject at least one metallic element or this metallic element, and forming the above-mentioned target thin film for X-ray generating on this middle thin film further.

[Claim 6] The above-mentioned middle thin film or the target thin film for X-ray generating is the manufacture approach of the transparency radiation mold X-ray tube according to claim 5 which forms membranes with physical vapor deposition, such as the sputtering method, the ion plating

method, or a vacuum deposition method.

[Claim 7] The manufacture approach of the transparency radiation mold X-ray tube according to claim 5 which prepares beforehand the ring for radioparency aperture maintenance which constitutes a part of above-mentioned vacuum housing, carries out airtight junction of the above-mentioned radioparency aperture plate at this ring for radioparency aperture maintenance, carries out sequential membrane formation of a middle thin film and the target thin film for X-ray generating after that at the inside side of said radioparency aperture plate, and carries out airtight junction of that ring for the account radioparency aperture maintenance of Gokami at the remaining part of a vacuum housing.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention is [0002] about this seed X-ray tube that prevented beforehand interfacial peeling of the target thin film for X-ray generating formed in the inside of the X-ray emission aperture plate which serves as a part of that vacuum housing, and its manufacture approach with respect to a transparency radiation mold X-ray tube and its manufacture approach.

[Description of the Prior Art] The X-ray tube has the composition of making an electron beam colliding with an anode plate target, and generating an X-ray. This X-ray tube is used for many applications, such as industrial use, such as medical diagnostic equipment, nondestructive inspection, and ingredient analysis. And the X-ray tube of various classes is put in practical use according to the application. The transparency radiation mold X-ray tube which acquires a minute focus, i.e., a micro focus X-ray generation source, is in one of them.

[0003] One of the applications of this micro focus transparency radiation mold X-ray tube is radioscopy macroradiographic equipment of a semiconductor integrated circuit substrate or other bodies. As the outline configuration is shown in drawing 7, X-ray tube 12 is arranged inside the equipment case 11 by which X-ray electric shielding was carried out. And a body 13 like a semiconductor integrated circuit substrate taken a photograph is put on the location which only distance La separated from the X-ray generating focal location S of this X-ray tube 12. Moreover, it is arranged so that the sensor side of an X-ray area sensor 14 like the X-ray image tube or a solid-state X-ray sensor may be located in the location where only distance Lb separated from the location of this body 13 taken a photograph further.

[0004] To X-ray tube 12, operating voltage is supplied from the power source 15 built in the case 11, and this is controlled from the outside. Moreover, the X-ray picture signal outputted from the X-ray picture signal output part 16 of the X-ray area sensor 14 is sent to the monitor 17 having an image processing system, and it is constituted so that the radioscopy photomacrography image of the body 13 taken a photograph may be displayed on the image display section 18.

[0005] The dilation ratio M of the roentgenography of the body taken a photograph is $M = (La + Lb) / La$ in general. It is expressed. However, in order to set up so that it may be set to $(La \ll Lb)$, a dilation ratio M becomes large, so that distance La is made small. Moreover, as the size of the focus S which is the X-ray generation source of an X-ray tube is small, it is also more obvious that a clear radioscopy photomacrography image with high resolution is obtained.

[0006] Therefore, the configuration which arranges the focus S of an X-ray tube, i.e., an X-ray generating target part, near the body 13 taken a photograph as much as possible, and can make distance La as small as possible is desirable. Use of the micro focus transparency radiation mold X-ray tube with which the X-ray generating target section exists in the tip of an X-ray tube is suitable for this purpose.

[0007] The radioparency aperture plate 22 with which this type of X-ray tube 12 penetrates an X-ray to the point of one near metal body of a vacuum housing 21 as shown in drawing 8 is formed in the vacuum airtight. This transparency aperture plate 22 usually consists of ingredients with high permeability to X-rays, such as beryllium (Be). Moreover, it adheres to the anode plate

target thin film 23 which consists of a tungsten (W) etc. directly in the field by the side of the vacuum of this radiopacity aperture plate 22 so that an important section may be expanded and shown. And the cathode 24 which generates an electron beam in the square of the other side in a vacuum housing is arranged, and the electron gun 25 which consists of it and two or more grid electrodes for electron lenses is arranged.

[0008] In the above-mentioned configuration, electron beam e which was generated from cathode and passed through the electron gun 25 connects the point focus S with the location of the anode plate target thin film 23. And the X-ray generated with this anode plate target thin film is emitted outside through the transparency aperture plate 22 as it is. This radiation X-ray is expressed with Sign X, and it is used for roentgenography.

[0009] Such equipment or an X-ray tube is indicated by each official report of a U.S. Pat. No. 5077771 specification, the Japanese patent No. 2713860, this patent No. 2634369, JP,7-50594,B, JP,9-171788,A, JP,52-56778,Y, or JP,54-163885,U etc.

[0010] In addition, the optimal thickness is different with the electrical potential difference which impresses the thickness of the tungsten thin film which constitutes the anode plate target of a transparency radiation mold X-ray tube to an X-ray tube. for example, the electrical potential difference which is impressed to an X-ray tube in the case of the X-ray tube used for industrial use -- several 10kV- 100 -- the range of dozens of kV is general. In such a case, the thickness with the optimal tungsten thin film which constitutes an anode plate target serves as the range of several micrometers - about ten micrometers.

[0011]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the way, a differential thermal expansion with the beryllium which constitutes the residual stress or the transparency aperture plate in the thin film generated in case a tungsten thin film is formed etc. influences, interfacial peeling tends to occur between beryllium, and the structure where the tungsten thin film which constitutes an anode plate target was made to adhere to the inside of the radiopacity aperture plate made from beryllium directly will tend to become unstable.

[0012] In order to make the electron beam with which a diameter serves as focal size of dozens of micrometers or the approximate circle form not more than it at a tungsten thin film collide in a micro focus transparency radiation mold X-ray tube especially, interfacial peeling tends to happen in this minute focal part. When this interfacial peeling happens, also when resulting in the fatal damage on an X-ray tube, it thinks by melting of a tungsten thin film, scattering of an exfoliation object, etc. by the local irradiation of an electron beam.

[0013] This invention solves the above-mentioned fault, prevents beforehand interfacial peeling between a radiopacity aperture plate and a target thin film, and aims at offering a reliable transparency radiation mold X-ray tube and its manufacture approach.

[0014]

[Means for Solving the Problem] The tungsten or tungsten which this invention is prepared in a part of vacuum housing at the vacuum side of the radiopacity aperture plate made from beryllium by which airtight junction was carried out, and this radiopacity aperture plate, and generates an X-ray between the target thin films which consist of an alloy made into a subject. For example, it is the transparency radiation mold X-ray tube formed by the middle thin film of at least one layer which consists of an ingredient which makes a subject at least one metallic element like copper or this metallic element sticking to these radiopacity aperture plate and the target thin film for X-ray generating, respectively.

[0015] Moreover, the manufacture approach of this invention is characterized by the middle thin film of at least one layer which consists of an ingredient which makes a subject the metallic element chosen from at least one metallic element, for example, copper and chromium, iron, or nickel on the inside of the radiopacity aperture plate made from beryllium, or this metallic element, and forming the target thin film for X-ray generating with physical vapor deposition, such as sputtering, on this middle thin film further.

[0016]

[Embodiment of the Invention] The operation gestalt of this invention is explained with reference to drawing 1 thru/or drawing 4 . Micro focus transparency radiation mold X-ray tube 30 shown in

this drawing is equipped with the vacuum housing 33 to which the metal cylinder container part 32 by which the glassware part 31 and the tip were closed was joined by the vacuum airtight. The electron gun 34 is arranged inside this vacuum housing 33. This electron gun 34 is equipped with the cathode 35 which generates an electron beam, and two or more grid electrodes for electron lenses. In addition, the operating voltage with which the example of the X-ray tube explained here is impressed between electron beam acceleration voltage, i.e., cathode, and an anode plate target thin film is the thing of the range of 50-70kV.

[0017] Now, the brazing and soldering of the radioparency aperture 37 to which the point of the metal cylinder container part 32 of a vacuum housing becomes the ring 36 for X-ray emission aperture maintenance from the alloy which makes a subject the beryllium (Be) or beryllium which is an ingredient with the high rate of radioparency are carried out to the vacuum airtight by the wax material layer 38. The ring 36 for X-ray emission aperture maintenance is formed in a machine target like heavy-gage iron (Fe), an iron alloy like covar (trade name) or stainless steel, copper (Cu), or a copper alloy with the ingredient of high intensity. And the vacuum-tight joint of the periphery thin-walled part 36a extended in the shape of [the] a taper by the method of outside is carried out to tip opening 32a of a metal cylinder container part by Heliarc welding.

[0018] Membranes are formed, and the middle thin film 39 which consists of a pure copper (Cu), and the anode plate target thin film 40 which consists of a tungsten (W) carry out a laminating to the inside of the radioparency aperture plate 37 made from beryllium, i.e., the field by the side of a vacuum field, and this order adheres to it in it. In addition, on the occasion of actuation of this X-ray tube, electron beam e which was generated from cathode 35 and passed through the electron gun 34 connects Focus S with the location of the anode plate target thin film 40 to the conventional technique having described similarly. And the X-ray generated in this focal location is emitted outside, as Sign X shows through the radioparency aperture 37 as it is, and it is used for roentgenography etc.

[0019] Next, drawing 3 and drawing 4 explain the desirable assembly of the radioparency aperture plate 37, the middle thin film 39, and the anode plate target thin film 40, or a membrane formation process. First, as shown in (a) of drawing 3, as wax material, 50% and copper have arranged 50% of silver alloy wax material, and silver has arranged the radioparency aperture plate 37 which consists of a disk made from beryllium whose thickness is about 1mm further to level difference 36b of opening of the ring 36 for aperture maintenance which processed the predetermined configuration beforehand, heat-treated to it in the non-oxidizing atmosphere, and performed the airtight brazing and soldering by the melting wax material 38 to it.

[0020] Next, membranes were formed by the sputtering method so that thickness might be set to about 0.4 micrometers, and the middle thin film 39 which becomes the inside of the radioparency aperture 37 made from beryllium in the condition of having been joined to the ring 36 for aperture maintenance from copper was made to adhere directly, as it arranges in the sputtering membrane formation equipment 50 which shows this to drawing 4 and is shown in (b) of drawing 3.

[0021] Next, membranes were formed by the sputtering method and the thin film 40 of a tungsten was made to adhere within the same sputtering membrane formation equipment, on the middle thin film 39 which consists of copper so that thickness may be set to about 4 micrometers as shown in (c) of drawing 3. Then, the ring 36 for aperture maintenance which has the radioparency aperture plate 37 which formed the middle thin film and the tungsten thin film in this way was put on tip opening 32a of a metal cylinder container part as shown in drawing 1, and the thin cylinder edge where both agreed was joined to the vacuum airtight by Heliarc welding, it considered as the vacuum housing, the electron gun etc. was incorporated into this vacuum housing, and the X-ray tube was completed through the exhaust air process etc.

[0022] The sputtering membrane formation equipment 50 shown in drawing 4 is a (direct-current DC) two-poles sputtering system known ordinarily. The target material for [sign / 51 / of this drawing] sputtering in a vacuum or a reduced pressure container, and 52 and 53, The target standing ways where 54 fixes these target material, and 55 shield. The refrigerant through which target fixed Taizhoug is made to circulate in order that 56 may cool an insulator and 57 may cool target material, The substrate installation base in which 58 lays a shutter and 59 lays the

substrate formed membranes, the control valve by which 60 controls installation of an exhaust air pump and gas [like argon gas] for discharge whose 61 is, and 62 express DC power supply, respectively.

[0023] Then, the ring 36 for aperture maintenance which carried out the brazing and soldering of the radioparency aperture plate 37 made from beryllium shown in (a) of drawing 3 is carried on the substrate installation base 59, and it considers as touch-down potential with the reduced pressure container 51. On the other hand, it fixes to the target standing ways 54 possible [replacement of the target material 52 which consists of copper, and the target material 53 which consists of a tungsten]. The minus pole of DC power supply 62 is electrically connected to these target standing ways 54.

[0024] And while introducing the gas 63 for discharge, for example, controlling in predetermined pressure of about 10Pa so that an arrow head shows after exhausting the interior of the reduced pressure container 51 to a vacuum, the predetermined electrical potential difference of about 1kV is impressed from DC power supply 62, and the discharge plasma is generated in a reduced pressure container. Next, a shutter 58 is controlled and a copper middle thin film is formed on the field of the radioparency aperture plate 37 from the target material 52 which consists of copper first.

[0025] Next, the target thin film which transposes to the target material 53 which consists of a tungsten, and consists of a tungsten on a middle thin film is formed. In this way, the laminating of the middle thin film 39 and the target thin film 40 is continuously carried out to the inside of the transparency aperture plate 37 of the X-ray tube shown in (c) of drawing 3, and membranes are formed.

[0026] The example shown in drawing 5 extends further the middle thin film 39 which consists of copper, and the target thin film 40 which consists of a tungsten from the inside of the radioparency aperture 37 made from beryllium to the middle of the inside taper side of the ring 36 for transparency aperture maintenance, and carries out sputtering covering. The extension of these middle thin film and a target thin film is expressed with Signs 39a and 40a, respectively.

[0027] According to this example, there is no un-arranging in actuation of an X-ray tube in any way, and there is an advantage of not interfering masking even if comparatively rough, on the occasion of membrane formation of the middle thin film 39 and the target thin film 40 rather.

[0028] The example shown in drawing 6 carries out the laminating of the middle thin film 39 which becomes the inside of the radioparency aperture plate 37 made from beryllium from two-layer 39b and 39c, forms membranes, and forms the target thin film 40 to the inside. The ingredient of the middle thin film 39 which consists of two-layer uses middle thin film 39b for example, by the side of a radioparency aperture plate as iron (Fe), and is good also considering middle thin film 39c by the side of a target thin film as titanium (Ti). Coefficient of thermal expansion is arranged by descending toward the tungsten of the target thin film 40 from the beryllium which is the radioparency aperture plate 37, and interfacial peeling between each class is further controlled by it.

[0029] In addition, the middle thin films 39b and 39c can use for example, not only the above but middle thin film 39b as gold (Au), and can also use middle thin film 39c as chromium (Cr). Or middle thin film 39b can be used as copper (Cu), and middle thin film 39c can also be made into a tantalum (Ta) again. In addition, various combination is possible. Moreover, it is possible not only two-layer but to carry out a laminating more than three layers or it.

[0030] Thus, even if the manufactured micro focus transparency radiation mold X-ray tube carried out long duration continuation of the radiation of a minute focal X-ray, interfacial peeling of a copper middle thin film and the target thin film made from a tungsten did not happen from a radioparency aperture plate, but high dependability was acquired. That main reason is considered that the ion implantation phenomenon to the inside of a substrate metal exists by part for these field surface part while the aperture material made from beryllium adheres to a middle thin film in high adhesion force with high energy and this middle thin film adheres to the target thin film made from a tungsten in high adhesion force still more nearly similarly by that it is comparatively easy to alloy the middle thin film which consists of a beryllium plate which constitutes a radioparency aperture, and copper, and the sputtering forming-membranes method. In this way,

good adhesion is acquired in respect of each field, and it is thought that it has been hard that it comes to generate interfacial peeling.

[0031] By the way, if the penetration depth of the electron to the inside of a metal is the same metal as known well, it is proportional to the n -th power of electronic acceleration voltage. Here, n is about 1.7. Then, when the anode plate target of an X-ray tube is a tungsten, the penetration depth of an electron with an acceleration voltage of 30kV is about 1 micrometer, and the penetration depth of an electron with an acceleration voltage of 100kV is about 8 micrometers.

[0032] Therefore, when thickness of the tungsten thin film which constitutes the anode plate target is set to about 4 micrometers like the above-mentioned example The penetration depth of the electron in actuation with an acceleration voltage of 50kV from the front face of a tungsten thin film to about 2.5 micrometers While advancing into the whole in general in the thickness of about 4 micrometers, i.e., a tungsten thin film, from the front face of a tungsten thin film in actuation with an acceleration voltage of 70kV and emitting an X-ray efficiently To a copper middle thin film or the radiopacity aperture plate made from beryllium, an electron does not reach but causing un-arranging is prevented beforehand.

[0033] In addition, especially since using the alloy which makes a subject the metallic element or it with the atomic number smaller than the tungsten which is the subject metal of an anode plate target thin film as a middle thin film, and a compound absorbs the generated X-ray un-wanting, it is desirable. However, if that thickness is thinly formed even if it uses an ingredient with the atomic number comparatively high as a middle thin film, X dosage absorbed with this middle thin film can be made small to extent which can be disregarded. On the other hand, although it is [some], the heat leakage nature from a target thin film is also raised by existence of a middle thin film.

[0034] Based on such a reason, the thickness of the tungsten thin film which constitutes the anode plate target can be manufactured in the optimal thickness in consideration of the application of this seed X-ray tube, and the range of working electron beam acceleration voltage. Moreover, the material of an anode plate target thin film is not restricted to a pure tungsten, for example, a minute amount **** rhenium tungsten alloy and molybdenum (Mo) may be used for a rhenium (Re), and a minute amount **** tungsten subject's alloy may be used for it for a minute amount **** molybdenum tungsten alloy or other elements.

[0035] On the other hand, although a pure copper (Cu) is desirable as mentioned above as an ingredient, minute amount **** is sufficient as the middle thin film 39 not only in it but other elements, or the following ingredients can be used for it. That is, you may be the ingredient chosen from the alloy or compound which makes a subject chromium (Cr), iron (Fe), nickel (nickel), silicon (Si), titanium (Ti), a zirconium (Zr), niobium (Nb), a rhodium (Rh), gold (Au), silver (Ag), or these at least one metallic element, for example. Or you may be the laminating of being not only one layer of the thin film of the ingredient chosen from these again but two or more thin films. In addition, use of the metallic material with which the atomic number and the rate of X-ray absorption are smaller than the tungsten which is the subject of an anode plate target thin film, and the melting point exceeds about 950 degrees C as mentioned above is desirable especially in manufacture of an X-ray tube, or on working stability.

[0036] Moreover, the thinner possible one of the thickness of this middle thin film 39 is desirable in the range which does not produce interfacial peeling between this, the radiopacity aperture plate 37, or an anode plate target thin film. As a result of examining this variously, it has checked being the range of $1/50$ thru/or $1/2$ of the thickness of the anode plate target thin film 40, and that it was desirable more preferably to make it the range of $1/30$ thru/or $1/3$.

[0037] In addition, it is the range which functions on insurance and stability as a vacuum housing also at the time of actuation, and, as for the thickness of the radiopacity aperture plate 37, constituting as thinly as possible is desirable.

[0038] the membrane formation approach of a middle thin film or an anode plate target thin film - the so-called physical vacuum evaporatio [vacuum deposition method / not only the above-mentioned sputtering method but / the ion plating method or a vacuum deposition method] (PVD) — law is suitable. Moreover, the whole may be formed with the combination of these approaches.

[0039] Moreover, radiations, such as a gamma ray, shall be included in an expression called the above-mentioned X-ray.

[0040]

[Effect of the Invention] According to this invention, interfacial peeling of the target thin film of the tungsten subject who formed membranes to the inside of the X-ray emission aperture plate made from beryllium can be prevented beforehand, and a reliable transparency radiation mold X-ray tube and its manufacture approach can be realized.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is drawing of longitudinal section of the X-ray tube in which 1 operation gestalt of this invention is shown.

[Drawing 2] It is the sectional view expanding and showing the important section of drawing 1 .

[Drawing 3] It is important section drawing of longitudinal section showing the assembly and membrane formation process of the X-ray emission aperture plate of drawing 1 , and a target thin film.

[Drawing 4] It is the schematic diagram showing the sputtering system applied to the manufacture approach of this invention.

[Drawing 5] It is important section drawing of longitudinal section of the X-ray tube in which other operation gestalten of this invention are shown.

[Drawing 6] It is important section drawing of longitudinal section of the X-ray tube in which the operation gestalt of further others of this invention is shown.

[Drawing 7] It is the schematic diagram showing X-ray macroradiographic equipment.

[Drawing 8] It is drawing of longitudinal section showing the conventional X-ray tube.

[Description of Notations]

33 -- Vacuum housing

34 -- Electron gun

36 -- Ring for radioparency aperture maintenance

37 -- Radioparency aperture plate

39 -- Middle thin film

40 -- Anode plate target thin film

50 -- Sputtering membrane formation equipment

[Translation done.]